



2016第17届电子封装技术国际会议 (ICEPT 2016)

尊敬的_____先生/女士，您好！

2016第17届电子封装技术国际会议(ICEPT 2016)将于2016年08月在武汉召开。

会议通知

Professional Development Courses of ICEPT 2016
August 2016 | Wuhan China

Mechanical Heterogeneous Electronic density power Reliability High power Packaging Thermo strategies Advanced IC Electrical integration 3D packages Modeling Analog Circuit Integrated Product Simulation Test

关于ICEPT

从1994年开始，在电子学会的指导下，由中国电子学会电子制造与封装技术分会组织的电子封装技术国际会议（ICEPT）已经在北京、上海、深圳、西安、桂林、大连、成都等地召开了十五届。ICEPT为业内的专家、学者和工程技术人员搭建了一个交流电子封装技术发展趋势的平台。

中国半导体产业于1956年十二年科学技术规划开始，经过50多年的发展，目前已形成设计、芯片制造、封装测试三个完整产业链，2013年我国半导体产业实现销售额4044.5亿元，占国内市场份额38.3%，占世界半导体市场份额21.4%。

1956年中国第一只晶体管诞生，我国半导体封装开始起步。近10年来，中国封测业成长尤为迅速。封测企业总数由2001年的70余家，发展到目前的330余家，销售额占据半导体产业的半壁江山。在系统级封装、2.5D/3D、硅通孔（TSV）互连技术、晶圆级高密度封装技术、SIP封装技术以及与封装相关的材料和设备的研发与世界先进水平的差距正在快速缩小，并已积累了一些技术和产业优势。

尽管如此，中国在封测领域的研发还基本没有形成完整的创新体系，有影响的成果还不多，最先进的封装测试领域也面临布局不到位，没有展现争先的远景，随着半导体晶圆的制造技术快速进入“后摩尔”时代，封装技术的发展迎来了更大挑战，以满足低成本、小尺寸、高速、高密度和高性能的市场需求，并提供局部超越甚至全面领先的机会。

因此，电子封装技术国际会议坚持在互相学习、互相交流与合作的原则下，为中国国内电子封装高端人才的培养作出一定的贡献，为世界电子封装业的技术交流作出一定的贡献，共同面对许多国家面临的机遇和挑战。

中国电子学会电子制造与封装技术分会希望与全球的封装会议与组织：如IEEE-CPMT，IMAPS，iNEMI，ECTC，ESTC，EPTC，建立长期稳固的合作关系。

大会组织

大会主席

毕克允	中国电子协会常务理事、中国电子学会电子制造与封装技术分会理事长、中国半导体行业协会副理事长
-----	---

大会共同主席

张尧学	中国工程院院士、中南大学校长
薛捷	IEEE-CPMT主席、美国思科系统公司研发总监

张国旗	荷兰代尔夫特大学教授
刘建影	上海大学教授、查尔姆斯理工大学教授、瑞典皇家工程院院士
樊学军	美国拉马尔大学教授

大会秘书

何虎	中南大学
陈相宇	中国电子学会电子制造与封装技术分会

国际咨询委员会

钟掘	中国工程院院士、中南大学教授
邹世昌	中国科学院院士、中科院上海微系统所研究员
许居行	中国工程院院士、中国电子科技集团公司(CETC)第58研究所荣誉所长
龚克	南开大学校长、俄罗斯宇航科学院外籍院士
Rolf Aschenbrenner	德国弗劳恩霍夫协会可靠性和微集成研究所副所长、IEEE-CPMT前主席
Ricky S. W. LEE	香港科技大学教授、IEEE-CPMT前主席
叶甜春	中科院微电子所所长、“02”专项总体组组长
William T.CHEN	日月光半导体制造股份有限公司(美国)高级顾问、IEEE-CPMT前主席
C.P. WONG	中国工程院外籍院士、香港中文大学教授、佐治亚理工学院教授
Rao TUMMALA	佐治亚理工学院教授、封装研究中心主任
Tadatomo SUGA	日本东京大学教授
张金国	科技部高新技术开发中心主任
刁石京	工业和信息化部电子信息司司长
徐晓兰	中国电子学会秘书长
余寿文	清华大学前副校长
Eric Beyne	比利时微电子研究中心(IMEC)三维系统集成项目主任
陈长生	CETC 15所研究员
杨银堂	西安电子科大副校长
马莒生	清华大学教授

技术委员会

技术委员会主席

刘胜	武汉大学
----	------

技术委员会共同主席

赖志明	江苏长电科技股份有限公司
刘胜	武汉大学
蔡坚	清华大学
刘勇	美国仙童半导体公司
李军辉	中南大学
田艳红	哈尔滨工业大学
肖斐	复旦大学

技术委员会秘书

王聪	中南大学
Tina YANG	ASTRI, HK, China

技术委员会主题分会

先进封装与系统集成	
主席	

Wenqi ZHANG	National Center for Advanced Packaging, China
Chengqiang CUI	AKM Electronics Technology (Suzhou) Company Ltd
成员	
Charlie Lu	Altera
Uihyoung Lee	Samsung Electronics Co., Ltd.
Gs Kim	Kangnam University
Cheng Yang	Intel China
Lei Shan	IBM
Wei Lin	Amkor
John Xie	Altera
Hu He	Central South University
Hao Yu	Nanyang Technological University

封装材料与工艺	
主席	
Changqing LIU	Loughborough University, UK
成员	
Liangliang Li	Tsinghua University, China
Anmin Hu	Shanghai Jiaotong University, China
Zhiheng Huang	Sun Yat-sen University
Xin-Ping Zhang	South China University of Technology
Zhong Chen	Nanyang Technological University, Singapore
Young-Bae Park	Andong National University, Republic of Korea
Fengqun Lang	National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, Japan
Zhiquan Liu	The Institute of Metal Research, CAS, China
Paul Wang	MSI
Su Wang	Shanghai Sinyang Materials, China
Longzao Zhou	Huazhong University of Science and Technology, China

封装设计与模拟	
主席	
Fei QIN	Beijing University of Technology, China
Jiantao ZHENG	Qualcomm Technologies Inc., USA
成员	
Hua LU	Greenwich University, UK
Yan Zhang	Shanghai University, China
Zhongping BAO	Qualcomm, USA
Bin XIE	ASTRI, China
Hongfei YAN	Intel, USA
Xiaowu ZHANG	IME, Singapore
Jack HU	Wuhan University, China
Wenchao TIAN	Xidian University, China
Xiujuan ZHAO	Philips, Netherlands
Min MIAO	Beijing Information Science and Technology University, China
Qing ZHOU	Intel, USA
An XIAO	NXP, Netherlands
Qiang WANG	Cisco Systems Inc., China
Tong AN	Beijing University of Technology, China
Fei SU	Beihang University, China
Xingchang WEI	Zhejiang University, China

互连技术	
------	--

主席	
Qian WANG	Tsinghua University, China
Tielin SHI	Huazhong University of Science and Technology, China
成员	
Dayuan Yu	Tianshui Huatian Technology Co., Ltd.
Xin Gu	Shennan circuits Co., Ltd.
Rong Sun	Shenzhen Institutes of Advanced Technology Chinese Academy of Sciences
Bing An	Huazhong University of Science and Technology
Yinghui Wang	The University of Tokyo

封装制造技术与设备

主席	
Liang TANG	CETC Beijing Electronic Equipment CO., LTD, China
Fuliang Wang	Central South University, China
成员	
Zhenqiu Liu	Tokyo Electronics Pte Ltd, Japan
Jianmin Xiong	BESI, China
Haiyang Gu	45th Research Institute of CETC, China
Chang Zhou	SMEE, China
K.H. Tan	JCAP, China
Li Gong	SUSS, China

质量与可靠性

主席	
Ming XUE	Infineon, Singapore
Fei XIAO	Fudan University, China
成员	
Hsien-Chie Cheng	Feng Chia University
Dongji Xie	NVIDIA Corporation
Liping Zhu	TriQuint Semiconductor
Xiuzhen Lu	Shanghai University
Boyi Wu	Flextronics Manufacturing Company
Klaus Galuschki	SIEMENS
Daoguo Yang	Guilin University of Electronic Technology

微波与功率器件封装

主席	
Yong LIU	Fairchild, USA
成员	
Przemyslaw Jakub Gromala	Robert Bosch GmbH
Jifa Hao	Fairchild Semiconductor
Jialiang Wen	Smart Grid Research Institute
Xueru Ding	Autoliv Active Safety
Zhaoqing Chen	IBM
Shanqi Zhao	MacMic Science & Technology Co., Ltd.
Ziyang Gao	Hongkong Applied Science & Technology Research Institute
Klaus Neumaier	Fairchild Semiconductor
Lihua Liang	Zhejiang University of Technology
Jianyong Xie	Intel
Meiling Wu	National Sun Yat-Sen University

固态照明封装与集成

--	--

主席	
Yan LIU	Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen, China
Willem Van Driel	Philips Lighting, Netherlands
成员	
Hai Hu	Research Institute of Tsinghua University in Shenzhen
Lianqiao Yang	Shanghai University
Haibo Fan	NXP, HongKong
Guoqiao Tao	Philips Lighting Shanghai
Liangbiao Chen	Lamar University
Cheng Qian	State Key Lab, SSL
Xiaobing Luo	Huazhong University of Science and Technology
Yong Tang	South China University of Technology
Jian Gao	Guangdong University of Technology
Yi Luo	Dalian University of Technology

新兴领域封装

主席	
Jintang SHANG	Southeast University, China
Le LUO	Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology (SIMIT), China
成员	
Mark Huang	Suzhou Speed Semiconductor Technology Co.,LTD.
Zhenfeng Wang	SIMTech
Changhai Wang	Heriot-Watt University
Jim Leu	Chiao Tung University
K. Suganuma	Osaka University
Ning Zhao	Dalian University of Technology
Zhuo Li	Houston Technology Center of CNPC
Mingxiang Chen	Huazhong University of Science and Technology
Cheng Yang	Shenzhen Research Institute of Tsinghua University
Pradeep Dixit	Indian Institute of Technology Bombay

组织委员会

组委会主席

段吉安	中南大学
-----	------

组织委员会共同主席

武祥	中国电子科技集团公司48所
曹立强	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
王春青	哈尔滨工业大学
郑宏宇	中国电子科技集团公司
田忠	电子科技大学
李明	上海交通大学
张建华	上海大学
杨道国	桂林电子科技大学
陈田安	烟台德邦科技有限公司
吴汉明	中芯国际集成电路制造(上海)有限公司

组织委员会秘书

陈卓	中南大学
----	------

郑煜	中南大学
黄兴早	北京菲尔斯信息咨询有限公司

会议日程

2016年大会报告日程安排

时间：2016年8月17日

地点：会议厅（武汉光谷金盾大酒店三楼）

【特邀报告日程下载】

2016年PDC日程安排

时间：2016年8月16日

地点：晴川会议厅、琴台会议厅（武汉光谷金盾大酒店三楼）

【PDC课程日程下载】

	演讲者	主题	地点	时间
PDC - 1	Dr. Ning-Cheng Lee	It is Time for Low Temperature - Low Temperature Solders , New Development, and Their Applications	Qingchuan Hall	8:30-10:30
PDC - 2	Dr. Andrew Tay	Hygrothermomechanical Reliability of IC Packages	Qintai Hall	8:30-10:30
PDC - 3	John H. Lau	Fan-Out Wafer/Panel-Level Packaging and 3D Packaging	Qingchuan Hall	10:30-12:30
PDC - 4	Dr. Yong Liu	Modeling and Simulation for Analog and Power Electronic Packaging	Qintai Hall	10:30-12:30

2016年三维封装技术特别研讨会日程安排

时间：2016年8月16日

地点：晴川会议厅、琴台会议厅（武汉光谷金盾大酒店三楼）

【特别研讨会日程下载】

会议门票

会议门票

A类：2800人民币元/人（包含会议资料、8月17-19号的中餐）

B类：（学生）1500人民币元/人（同上）

C类：3800人民币元/人（高级标准间1床位，2人合住，含会议资料、8月17-19日的中餐，17、18、19日的晚餐和住宿）

D类：4600人民币元/人（高级标准间或单人房，单住，其它同上）

